

社團法人台灣電子設備協會 函

機關地址：110 台北市信義路五
段 5 號 3 樓 3E41 室
聯絡人：楊慧卿小姐
聯絡電話：02-27293933#17
電子郵件：vivi@teeia.org.tw
傳真：02-27293950

受文者：弘光科技大學

發文日期：中華民國 110 年 8 月 18 日

發文字號：1100818081

速別：普通件

密等及解密條件或保密期限：普通

附件：半導體先進封裝測試設備種子師資培訓班

8/19
11370

主旨：敬邀全國公私立大專院校教師參加「半導體先進封裝測試設備種子師資培訓班(9/29-30)」，敬請惠予公告並轉知教師踴躍報名參加。

說明：

一、在經濟部產業專業人才發展推動計畫指導下，為協助推動技專校院人才發展計畫，培育人才，盼藉由先進封裝製程與設備技術種子師資培訓班，邀請對先進封裝製程與設備技術議題有研究的老師，與業界先進一同分享其研究與課程之規劃及授課經驗，期能有助於教師從創新培訓課程的設計及經驗，導入業界人才需求之課程，以提升學生實務之教學品質。

培訓對象：全國大專院校以上現職教師，預定 20 人(依各校報名先後順序安排學員)

二、培訓費用：免費，結業時本會將發給教師種子師資培育時數證明。
報名方式：

網路報名：<https://www.teeia.org.tw/zh-tw/Course/110092930/127>

報名時間：即日起至 110 年 9 月 17 日，額滿為止。

三、請各校惠予參與培訓人員公(差)假。

四、如有相關問題，請逕洽本案聯絡人：台灣電子設備協會 楊慧卿小姐，電話：02-27293933 ext. 17

正本：公私立大專校院

社團法人台灣電子設備協會

理事長

王作京